三井金属

2026年11月19日

各　位

VSP™を支える表面処理技術が「発明協会 東京優秀賞」を受賞
～高周波伝送の低損失化に貢献～

当社（社長：池信 省爾）は、このたび、高周波基板用電解銅箔「VSP™」に採用されている表面処理技術の開発者が、公益社団法人発明協会主催の令和8年度関東地方発明表彰*において、「発明協会東京優秀賞」を受賞しましたので、お知らせいたします。

今回受賞した発明「表面処理銅箔（特許第6975845号）」は、プリント配線板に使用される銅箔の表面処理技術に関するものです。樹脂基材との高い密着性と信頼性を確保しながら、銅箔表面の平滑性を高めることで、高周波信号の伝送損失低減に貢献しています。

本技術は、生成AI関連用途などで需要が拡大している「ハイグレードVSP™シリーズ」に採用されています。AIサーバーをはじめとするAIインフラの高度化に伴い、プリント配線板で扱われる信号の高速・高周波化が進んでいます。こうしたなか、高周波領域での伝送損失を抑制する同シリーズの需要は急速に拡大しており、今後もさらなる成長が期待されます。

当社は、「ハイグレード VSP™シリーズ」を、キャリア付極薄銅箔「MicroThin™」に続く成長製品と位置付け、今後も市場ニーズに応える技術開発と安定供給体制の強化を進め、拡大するAI・データセンター関連市場のニーズに応えてまいります。

当社は、パーパスである「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」を基軸に、2030年のありたい姿である全社ビジョン「マテリアルの知恵で “未来” に貢献する、事業創発カンパニー。」を実現することで、サステナブル（持続可能）な社会作りに貢献してまいります。

以　上

＊関東地方発明表彰は、大正10年に始まった歴史ある表彰制度で、優れた発明・考案を生み出した発明者や、その実用化に尽力した方々の功績を称え、顕彰するものです。

【お問い合わせ先】
三井金属　コーポレートコミュニケーション部
TEL　：03-5437-8028　E-mail：PR@mitsui-kinzoku.com

（ご参考）



汎用銅箔



VSP™

写真　アップルマンゴーが映り込んだ銅箔の表面

※VSP™は、鏡面のような優れた表面平滑性が特徴